【特征】有热风整平时硬拉的摸样, SR 或者板件上有 伤痕的缺陷。

[Characteristics] There are scratches on solder resist or board surface, which appear to be made by dragging of coated solder.

【原因・判断ポイント・発生工程】基板の反りやク ランプ不適などにより、HALはんだコーティング 時に基板がHAL装置に接触したまま引き上げられ たことにより出来たもの(HAL工程)

【原因、判断要点、发生工序】热风整平时板件翘曲 或者压板不合适等, 板件提升时碰撞 HAL 装置所引 起的(HAL工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

A board is dragged while it is in contact with the equipment in HAL solder coating due to the warping of the board or improper clamping. (HAL process)



【コメント】 顕微鏡倍率× 【注释】 显微镜倍率 ×

[Coments] Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率×60

[Coments] Magnification: ×60

SR 欠陥

シンボルマーク欠陥

機械加工欠陥

スルーホール欠陥

4-3-2-4 はんだ厚さむら/焊料的厚度不均匀/ Uneven solder thickness

【特徴】同一端子内や製品内のはんだコーティング の厚さに極端なむらがある状態の欠陥

【特征】在同一个插脚内或者同一种产品内,焊料的 厚度极不均匀的缺陷。

[Characteristics] There are excessive variations in the thickness of solder coating among lands of a board or among boards of the same type.

【原因・判断ポイント・発生工程】HALの噴射工 ア圧が低すぎたり、エア噴射ノズルが詰まったこと により出来たもの(HAL工程)

【原因、判断要点、发生工序】HAL 喷射风压太低、 或者喷嘴堵塞所引起的(HAL工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment] The defect is caused by too low an air jet pressure or

clogging of the air jet nozzles of HAL equipment (HAL process)



【コメント】 顕微鏡倍率×

显微镜倍率 ×

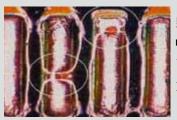
[Coments] Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率×

[注释] 显微镜倍率×

[Coments] . Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率×

【注释】 显微镜倍率×

[Coments] Magnification: ×